

## NEU in unserer Serie MicroCom

Die Vorteile von **extremer** EMV Dichtigkeit und **sehr kleinen Baugrößen** wurden jetzt erweitert um **gefilterte** Steckverbinder.

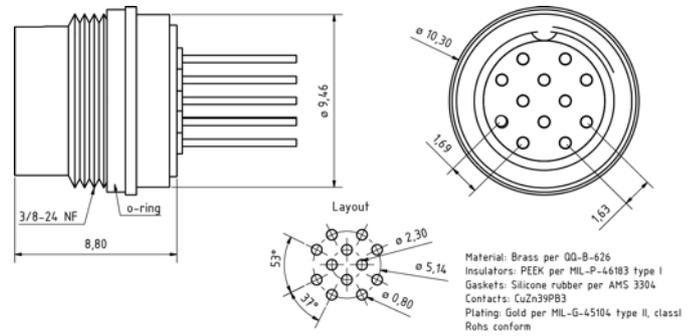
Die Anforderungen an EMV dichte Gehäuse und vor allem die Anbindung von Leitungen werden immer größer.

Frequenzen die über das Kabel in das Gehäuse gelangen können mittels EMV Filter an Masse abgeleitet werden.

Die Steckverbinder unserer Serie **MicroCom** bieten ideale Voraussetzungen.

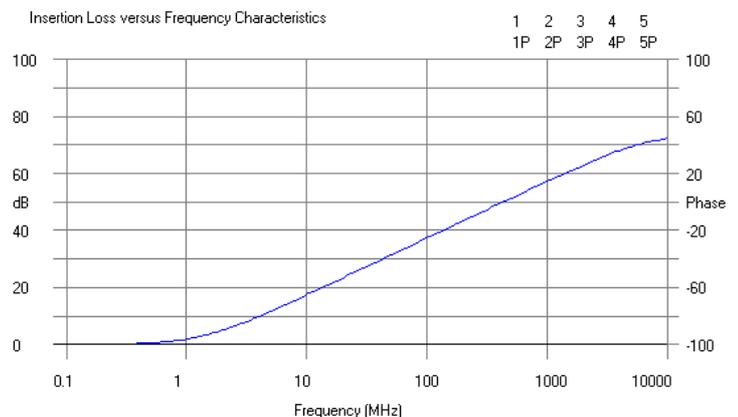


- Sehr kleine Baugrößen
- Mechanisch hoch belastbar
- Extreme EMV Dichtigkeit



Der Kabelsteckverbinder erhält eine zuverlässige Schirmanbindung durch Crimpung.  
Der Gehäusesteckverbinder wird eingelötet oder geschweißt.

Derzeit als Standard verfügbar die **12-polige Ausführung** zur **Leiterplattenanbindung** und Gehäusemontage.  
Bei eine Kapazität von **4,7nF** erhalten wir folgende Dämpfungen.



Weitere Varianten sind auf Anfrage verfügbar. Bitte sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.

Stand April 2013 Änderungen vorbehalten